

清華大學高能光電實驗室 技術性服務(晶圓切割) 申請表

單位名稱	
連絡人	
聯絡電話	公司： _____ 手機： _____
E-mail (必填) (為後續聯絡管道)	
聯絡地址	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
切割項目	<input type="checkbox"/> 四吋矽晶圓 <input type="checkbox"/> 六吋矽晶圓 <input type="checkbox"/> 玻璃 <input type="checkbox"/> 矽-矽接合晶圓 <input type="checkbox"/> 矽-玻璃接合晶圓 <input type="checkbox"/> 特殊材料： _____
切割軌道寬度	切矽晶圓：80um 切玻璃：180um 切矽-矽接合晶圓：130um 切玻璃-矽晶圓接合：180um
是否切穿	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
烤箱服務	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
備註	
連絡電話：03-5162340、黃先生、莊先生，傳真號碼：03-5162330， E-mail：nthu.cpr@gmail.com	
注意事項	1.收費標準： 學術單位：四吋 Si wafer 厚度 0.5mm 每片 400 元，四吋玻璃厚度 0.5mm 每片 500 元，切割一片時間若超過 20 分鐘則另計，以每 20 分鐘 400 元計價。 非學術單位：四吋 Si wafer 厚度 0.5mm 每片 600 元，四吋玻璃厚度 0.5mm 每片 700 元，切割一片時間若超過 20 分鐘則另計，以每 20 分鐘 600 元計價。 新客戶如自備刀片等耗材者，第一片實驗免費,第二片起依據本實驗室實驗片報價收費。如未自備刀片者，可由本實驗室代購刀片或起依據本實驗室實驗片報價收費。
	2.本單位收到報名表後將於近期內回覆 e-mail，若逾時未收到回覆，請來電洽詢。